

#### **PATENT ABSTRACTS OF JAPAN**

(11) Publication number: 10105242 A

(43) Date of publication of application: 24.04.98

(51) Int. CI

G05D 3/00

B23Q 1/28

G05D 3/12

H01L 21/027

H01L 21/68

(21) Application number: 08260411

(71) Applicant:

USHIO INC

(22) Date of filing: 01.10.96

(72) Inventor:

TANAKA YONETA

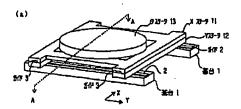
#### (54) XY STAGE POSITIONING DEVICE

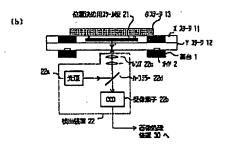
## (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To perform high-precision positioning without using an expensive length measuring means or increasing mechanical machining precision.

SOLUTION: On a base 1, an X stage 11 and a Y stage 12 which move in an X direction and a Y direction are provided and on the reverse surface of a θ stage 13 provided on the X stage 11, a positioning scale plate 21 given positioning marks in a grid pattern is fitted. To position the X and Y stages 11 and 12, a detecting device 22 detects the position of a positioning mark and after the position is stored, the X and Y stages 11 and 12 are moved by specific quantities. Then the position of the positioning mark is detected and a position where the positioning mark should be after movement is calculated from the distance between positioning marks on the positioning scale plate 21 and the said movement quantity, thereby moving the X and Y stages 11 and 12 so that the positioning mark is at the position after the movement.

# COPYRIGHT: (C)1998,JPO





# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平10-105242

(43)公開日 平成10年(1998) 4月24日

| (51) Int.Cl. <sup>6</sup> |        | 識別記号               | ···  | FI   |        |            |          |            |           |
|---------------------------|--------|--------------------|------|------|--------|------------|----------|------------|-----------|
| G05D                      | 3/00   | •                  |      | G 0  | 5 D    | 3/00       |          | Α          |           |
| B 2 3 Q                   | 1/28   |                    |      | B 2  | 3 Q    | 1/28       |          |            |           |
| G05D                      | 3/12   |                    |      | G 0  | 5 D    | 3/12       |          | L          |           |
| H01L                      | 21/027 |                    |      | H0   | 1 L    | 21/68      |          | K          |           |
|                           | 21/68  |                    |      |      |        | 21/30      |          | 520A       |           |
|                           |        |                    | 審查請求 | 未請求  | 旅館     | 項の数1       | OL       | (全 8 頁)    | 最終質に続く    |
| (21)出願番号                  |        | <b>特顯平8-260411</b> |      | (71) | 出願丿    | 000102     | 212      |            |           |
| ,, ,,,-                   |        |                    |      |      |        | ウシオ        | 電機株      | 式会社        |           |
| (22)出願日                   |        | 平成8年(1996)10月1日    |      |      |        | 東京都        | 千代田      | 区大手町2丁     | 目6番1号 朝   |
|                           |        |                    |      | l    |        | 日東海        | ピル19     | 階          |           |
|                           |        |                    |      | (72) | 発明者    | 計 田中       | 米太       |            |           |
|                           |        |                    |      |      |        | 神奈川<br>才電機 |          |            | 川町6409 ウシ |
|                           |        | •                  |      | (74) | 代理人    |            |          | 俊一郎        |           |
|                           |        |                    |      | `` ~ | , 4.2. | , ),       | <b>,</b> | <b>~</b> ~ |           |
|                           |        |                    |      |      |        |            |          |            |           |
|                           |        |                    |      |      |        |            |          |            |           |
|                           |        |                    |      |      |        |            |          |            |           |
|                           |        |                    |      |      |        |            |          |            |           |
|                           |        |                    |      |      |        |            |          |            |           |
|                           |        |                    |      | 1    |        |            |          |            |           |

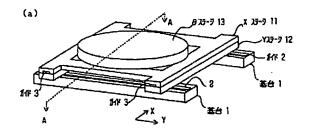
# (54)【発明の名称】 XYステージの位置決め装置

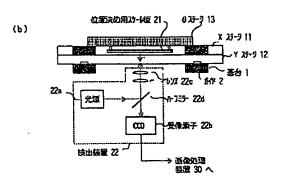
# (57)【要約】

【課題】 高価な測長手段を使用したり、機械的な加工 精度を上げることなく高精度な位置決めを行うこと。 【解決手段】 ベース基台1上に、X, Y方向に移動す るXステージ11、Yステージ12が設けられ、Xステ

ージ11上に設けられた $\theta$ ステージ13の裏面には、碁盤目状に位置決め用マークが付された位置決め用スケール板21が取り付けられている。X、Yステージ11, 12を位置決めにするには、検出装置22により位置決め用マークの位置を検出し、その位置を記憶したのち、X, Yステージ11, 12を所定量移動させる。ついで、位置決めマークの位置を検出し、位置決め用スケール板21上の位置決め用マーク間の距離と上記移動量から、移動後に位置決め用マークが位置すべき位置を演算し、該位置に移動後の位置決め用マークが位置するように、X, Yステージ11, 12を移動させる。

## 本発明の実施例のワークステージの全体構成を示す図





30

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 1方向にみに移動可能な第1のステージ

上記第1のステージを駆動する第1のステージ駆動手段 ٤.

上記第1のステージ上に載置され、第1のステージの移 動方向と直交する方向に移動する第2のステージと、

上記第2のステージを駆動する第2のステージ駆動手段 と、

上記第2のステージの裏面に設けられ、その表面に碁盤 10 状に設けられた複数の位置決め用マークを有する板状部 材と、

上記位置決め用マークを検出する検出手段と、

上記第1, 2のステージ駆動手段により上記第1, 2の ステージを移動させ、第1、2のステージを位置決めす る制御部とを備え、

上記制御部は、上記第1, 第2のステージが初期位置に あるとき、上記検出手段により検出された位置決め用マ ークの位置を記憶し、

上記第1, 2のステージ駆動手段により上記第1, 第2 20 のステージを所定量移動させたのち、上記検出手段によ り検出された位置決め用マークの位置を記憶し、上記碁 盤目状に設けられた複数の位置決め用マーク間の距離 と、上記所定の移動量から移動後に位置決め用マークが 位置すべき位置を演算し、

上記演算により求めた位置決め用マークが位置すべき位 置に、移動後に検出された位置決め用マークが位置する ように、上記第1、2のステージ駆動手段により上記第 1, 2のステージを移動させることを特徴とするXYス テージの位置決め装置。

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、逐次露光方式の露 光機等に使用されるXYステージの位置決め装置に関 し、特に本発明は、長ストロークを高精度に位置決めす ることができるXYステージの位置決め装置に関するも のである。

### [0002]

【従来の技術】レジストを塗布したワーク上の複数の露 光区域にマスクパターンを投影して各露光区域を露光す 40 るため、ワークステージを移動させながら、ワークステ ージ上に載置されたワークの各露光区域を逐次露光して いく逐次露光が行われる。上記逐次露光において、ワー クを第1回目に露光する際、すなわち、アライメント・ マークもマスクパターンも露光されていないワークを露 光するとき、図8に示すように、ワークW上の各露光区 域R1, R2, …のピッチが所定の精度内に入っている ことが要求される。一回目の露光における上記ピッチの 精度は、第2回目以降の露光の精度に影響するので、上 記ピッチ精度も第2回目以降の露光の精度と同程度にす 50 ビームスプリッタ54、ミラー53を介してミラー51

る必要があり、上記ピッチ精度としては±1μm程度の 精度が要求される。このため、ワークを軟置するワーク ステージも上記精度内で位置決めすることが必要とな る。

【0003】図8は上記逐次露光方式の露光機等に使用 されるワークステージの概略構成を示す図である。同図 において、1は基台であり、基台1の上にガイド2を介 してYステージ12が移動可能に取り付けられており、 Yステージ12の上にガイド3を介してXステージ11 が移動可能に取り付けられている。さらに、Xステージ 11の上にθステージ13が回転可能に取り付けられて いる。

【0004】4はボールネジ、5,6は駆動モータ、 7,8は駆動モータ5,6の回転量を検出するエンコー ダであり、ボールネジ4はX、Yステージ11、12に 取り付けられたハウジング部材9と係合している。 駆動 モータ6が回転すると、Yステージ12がY方向に移動 し、また、駆動モータ5が回転するとXステージ11が X方向に移動する。また、θステージ13は図示しない 駆動手段により Xステージ11上で回転する。また、駆 動モータ5、6の回転量はエンコーダ7、8により検出 され、図示しない制御部にフィードバックされ、制御部 は上記エンコーダ7,8により検出された駆動モータ 5, 6の回転量により、上記X, Yステージ11, 12 の位置を制御する。

【0005】上記したワークステージにおいて、必要な ピッチ精度を確保するには、X, Yステージ11, 12 の位置決め精度を向上させる必要がある。このため、従 来においては、次のような方法が採られていた。

(1) X, Yステージ11, 12を移動させるボールネ ジ4やガイド2、3等の送り機構の加工精度を上げて、 X、Yステージ11、12の移動精度を機械的に向上さ せる。これにより、駆動モータ5,6の回転量に対応し た虽だけX、Yステージ11、12を精度よく移動させ ることができ、駆動モータ5、6の回転量をエンコーダ 7,8により検出してフィードバック制御すれば、ワー クステージの髙精度な位置決めを実現することができ る。

【0006】(2)レーザ干渉計や測長ユニットを取り 付けるなどしてワークステージの髙精度な位置測定を行 い、必要な精度を確保する。図9は上記レーザ干渉測長 計を用いたワークステージの位置測定方法を示す図であ り、同図において、10はワークステージ(同図では、 図8示したX, Y, θステージ11, 12, 13をまと めてワークステージ10として示している)であり、ワ ークステージ10にはミラー51が取り付けられ、ミラ - 51はワークステージ10とともに移動する。

【0007】1は基台、52はレーザ干渉測長器であ り、レーザ干渉測長器から照射されるレーザビームは、 3

で反射し、レーザ干渉測長器52に戻り、レーザ干渉測 長器52は照射光と反射光との関係からミラー53とミ ラー51間の距離x、即ちワークステージ10のX軸方 向の距離を得る。また、レーザ干渉測長器52から照射 されるレーザ光は、ビームスプリッタ54→ビームスプ リッタ55を介してミラー51で反射し、レーザ干渉測 長器52に戻るとともに、ミラー56を介してミラー5 1で反射し、レーザ干渉測長器52に戻る。そして、レ ーザ干渉測長器52はビームスプリッタ55とミラー5 1間の距離y1、および、ミラー56とミラー51間の 距離y2を検出し、ワークステージのY方向の距離を得る。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記した (1) の方法で位置決め精度に上げるには次のような問題がある。

- ① 高精度な部品を使用する必要があり、また組み立て に精度が要求され、価格が高価になるとともに、組み立 て工数が増える。
- ② 温度変化等の影響により精度の保証が難しい。
- ③ エンコーダを設けて駆動モータの回転量を検出してフィードバック制御をしているが、直接X, Yステージの位置を検出していないので、X, Yステージ位置を確認することができない。

【0009】また、上記(2)の方法を用いれば、0.  $1 \mu m$ 程度の髙精度でワークステージを位置決めすることができるが、次のような問題点がある。

- ① レーザ干渉測長器は高価なので装置が高価格となる。
- ② 装置の構成が複雑化する。また、光軸の調整が必要 30 など、メインテナンス作業が難しくなる。

本発明は上記した従来技術の問題点を考慮してなされたものであって、高価な測長手段を使用したり、機械的な加工精度を上げることなく高精度な位置決めを行うことができるXYステージの位置決め装置を提供することである。

# [0010]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本発明においては、1方向にみに移動可能な第1のステージと、上記第1のステージを駆動する第1のステージと、上記第1のステージ上に載置され、第1のステージの移動方向と直交する方向に移動する第2のステージを駆動する第2のステージを駆動する第2のステージを駆動する第2のステージ駆動手段と、上記第2のステージの裏面に設けられ、その表面に碁盤状に設けられた複数の位置決め用マークを有する板状部材と、上記位置決め用マークを検出する検出手段と、上記第1,2のステージを検出する検出手段と、上記第1,2のステージを移動させ、第1,2のステージを位置決めする制御部とからXYステージの位置決め装置を構成する。そして、上記制御部が、上記第1,50

第2のステージが初期位置にあるとき、上記検出手段により検出された位置決め用マークの位置を記憶し、上記第1,2のステージ駆動手段により上記第1,第2のステージを所定量移動させたのち、上記検出手段により検出された位置決め用マークの位置を記憶し、上記碁盤目状に設けられた複数の位置決め用マーク間の距離と、上記所定の移動量から移動後に位置決め用マークが位置を演算し、該演算により求めた位置決め用マークが位置すべき位置に、移動後に検出された位置決め用マークが位置するように、上記第1,2のステージを移動させる。

【0011】本発明においては、上記のように、第1のステージの裏面に位置決め用マークを全面に設けた板状部材を取り付けるとともに、上記位置決め用マークの位置を検出する検出手段を設け、第1、第2のステージを所定 昼移動させたのち、上記位置決め用スケール板に設けられた位置決め用マークの位置を上記検出手段で検出し、検出結果に基づき位置ずれを補正するように構成したので、前記した高価なレーザ干渉測長器を使用することができる。また、第1、第2のステージの粗移動精度としては、目的とする位置決め用マークが検出手段の視野からはずれない程度の精度であればよいので、第1、第2のステージを移動させるボールネジやガイド等の送り機構に高精度な部品を使用する必要がなく、価格を低減化することができる。

#### [0012]

【発明の実施の形態】図1は本発明の実施例のワークステージの全体構成を示す図である。同図(a)は本実施例のワークステージの斜視図、同図(b)は(a)のAーA断面図を示しており、同図では、X, Yステージを駆動する駆動モータ等の駆動機構は省略されているが、前記図8と同様な駆動機構を備えている。

【0013】図1において、1は基台、11はXステージ、12はYステージ、13は  $\theta$  ステージであり、前記したように、基台1上にYステージ12がガイド2を介して移動可能に取り付けられており、Yステージ12の上にガイド3を介してXステージ11が移動可能に取り付けられている。さらに、Xステージ11の上に $\theta$  ステージ13が回転可能に取り付けられている。そして、X, Yステージ11, 12は図示しない駆動モータにより駆動されて同図矢印のX, Y方向に移動し、 $\theta$  ステージ13は図示しない駆動モータにより駆動されて回転する。また、上記駆動モータの回転量は、各駆動モータに取り付けられたエンコーダ(図示せず)により検出され、後述する制御部にフィードバックされる。

【0014】本実施例のX, Yステージ11, 12はその中央部に空間部が設けられており、 θステージ13の 裏面には、位置決め用スケール板21が取り付けられて
50 いる。また、上記位置決め用スケール板21に対向し

Δ

3/4程度(例えば200µmのピッチ)に設定するの が望ましく、また、位置決め用マークの大きさx, yは

上記画角の1/10~1/20が望ましい。

て、X, Yステージ11, 12の下側に、上記位置決め 用スケール板21上に印された位置決め用マークを検出 するための検出装置22が取り付けられている。検出装 置22は光源22aと、CCD等から構成される受像素 子22bと、ハーフミラー22dと、レンズ22cから 構成されており、光源22aから出た光はハーフミラー 22 d、レンズ22 cを介して位置決め用スケール板2 1に照射される。そして、その反射光がレンズ22c、 ハーフミラー22dを介して受像素子22bに入射す

【0020】本発明のXYステージ装置は、図4に示す ようにモニタ31の画面上に表示される位置決め用マー クの位置からXYステージの位置決めを行うので、上記 位置決め用マークをサーチする際、上記モニタ画面の中 に必要なマークが入ることが最低の必要条件となる。こ のため、本実施例のXYステージの粗移動精度(直進 度、ヨーイング、ウェービング等の幾つかの要求精度を 全て含んだ位置決め精度)として、モニタ31の画角の 1/10程度が要求される。

【0015】上記検出装置22の倍率は、要求される位 置決め精度により定まり、例えば、±1μm程度の位置 決め精度の場合には、10倍(受像素子22bにより受 像される画面が500μm角)程度とするのが望まし い。なお、同図では検出装置22を1つ設ける場合を示 しているが、複数の検出装置を設けることができ、後述 するように検出装置に数に応じて位置決め用スケール板 21の大きさを小さくすることができる。

【0021】次に、本実施例のXYステージによるX, Y方向の位置決めの手順を、前記したワークの各露光区 域(以下、各露光区域をサイトという)を逐次露光して いく逐次露光に適用した場合について説明する。なお、 以下の説明は、ワークに第1回目の露光をする場合(ワ ーク上にアライメント・マークもマスクパターンも露光 されていないワークに露光する場合)の手順である。

【0016】図2は本実施例のワークステージを制御す る制御部の構成を示す図であり、同図において、22b 20 は上記した受像素子であり、受像素子22bにより受像 された画像は画像処理装置30で処理されモニタ31に 表示される。コントローラ32は上記受像素子22bに より受像された位置決め用マーク像の位置に応じて、

【0022】(1) 図2に示したXステージ駆動機構3 3 a、Yステージ駆動機構33bによりX, Yステージ を駆動し、図1に示した θ ステージ13をエンコーダ3 4a, 34bにより定まる初期位置に移動させる。

X. Y. θステージ11.12.13を駆動するための 制御信号をXステージ駆動機構33a、Yステージ駆動 機構33b、θステージ駆動機構33cに与える。

(2) 8ステージ13上にワークを載置し、図示しない 露光光照射装置からマスクパターンが設けられたマスク を介して露光光をワークに照射し、ワークの最初のサイ トを露光する。このとき、検出装置22により位置決め 用スケール板21上の位置決め用マークを検出する。

【0017】Xステージ駆動機構33a、Yステージ駆 動機構33b、θステージ駆動機構33cは、前記した Xステージ11、Yステージ12、θステージ13を駆 30 動する駆動モータを含み、コントローラ32から与えら れる制御信号に応じて該駆動モータが駆動され、Xステ ージ11、Yステージ12、θステージ13が所定の位 置、角度に位置決めされる。また、上記駆動モータの回 転量はエンコーダ34a, 34b, 34cにより検出さ れコントローラ32にフィードバックされる。

【0023】(3)図1に示した検出装置22の受像素 子22bにより受像された画像を図2に示した画像処理 装置30に送って処理し、モニタ31に表示する。モニ タ31には、例えば、図5 (a) に示すように位置決め 用スケール板21上の位置決め用マークが表示される。 画像処理装置30は上記位置決め用マークのモニタ31 上の位置 (X0, Y0) を記憶する。

【0018】図3は上記位置決め用スケール板21に印 された位置決め用マークの一例を示す図であり、位置決 め用スケール板21には同図に示すように、その全面に 所定のピッチXp, Ypで位置決め用マークが印されて 40 いる。位置決め用スケール板21は温度変化の影響が小 さい石英マスクを用いるのが望ましく、上記位置決め用 マークは電子線描画装置等を用いて正確なピッチで描画 される。なお、位置決め用マークは、同図に示すように 同一のマークでよく、位置を特定できるものであればど のような形状のマークを使用してもよい。

(4) ワークの次のサイトが露光位置にくるように、X ステージ駆動機構33a、Yステージ駆動機構33bに より所定移動距離(X, Y)だけX, Yステージ11, 12を移動させる。X, Yステージ11, 12の駆動量 は前記したエンコーダ34a,34bにより検出され、 コントローラ32はエンコーダ34a、34bのカウン ト値が上記所定移動距離(X,Y)に対応した値になる ように、Xステージ駆動機構33a、Yステージ駆動機 構33bを駆動する。

【0019】図4は検出装置22により検出されモニタ 31の画面上に表示された位置決め用マークを示す図で ある。位置決め用マークのピッチXp 、 Yp は、同図に 示すように、モニタ31の画角(縦横の長さ)に対して so るボールネジ等による粗移動精度によるズレ(モニタ3

【0024】(5)検出装置22により位置決め用スケ ール板21上の位置決め用マークを検出し受像素子22 bにより受像された画像を画像処理装置30に送って処 理し、モニタ31に表示する。ここで、X、Yステージ 11, 12の移動量は、X, Yステージ11, 12を送 1の画角の1/10程度)を含むので、図5(b)に示すように、モニタ31の画面上の位置決め用マークの位置(Xreal, Yreal)は、本来あるべき位置(Xcou, Ycou)(同図の点線で示したマーク)に対してずれる。画像処理装置30は上記位置決め用マークのモニタ31上の位置(Xreal, Yreal)を記憶する。なお、位置決め用マークが所定のピッチ(Xp, Yp)で正確に描かれているとすると、モニタ31に表示される位置決め用マークの位置は、設計値±粗移動精度内の範囲に入り、粗移動精度を前記したようにモニタ31の画角の1 10/10程度にすれば、位置決め用マークがモニタ31の画角から外れることはない。

【0025】(6)上記所定移動距離(X, Y)と、位置決め用マークピッチ(Xp, Yp)、上記初期位置(X0, Y0)とから、位置決め用マークが本来あるべき位置(Xcow, Ycow)を画像処理装置30により算出する。図6は、上記位置決め用マークが本来あるべき位置(Xcow, Ycow)を求める方法を説明する図であり、例えば、所定移動距離(X, Y)=700、位置決め用マークピッチ(Xp, Yp)=200のとき、初期20位置(Xcow, Ycow)のズレ量は100なので、該位置(Xcow, Ycow)は同図に示すようになる。

【0026】 (7) モニタ31上の位置決め用マークが 上記本来あるべき位置 (Xcou , Ycou) に一致するよ うに、Xステージ駆動機構33a、Yステージ駆動機構 33bによりX, Yステージ11, 12を移動させる。

(8) 図示しない露光光照射装置からマスクパターンが 設けられたマスクを介して露光光をワークに照射し、ワ ークの次のサイトを露光する。

以下、上記(4)~(7)の処理を繰り返し、ワークの 各サイトを逐次露光する。

【0027】なお、モニタ31に表示された位置決め用マークの位置を、受像素子22bの画素で決まるピクセル値で補正すれば、X, Yステージ11, 12を上記位置決め用マークのピッチ(Xp, Yp)以下の精度で位置決めすることができる。また、位置決め用スケール板21上の位置決め用マークのピッチ精度が悪い場合には、上記位置決め用スケール板21に対して、本出願人が先に提案した特願平6-117871号に示した方法40でマッピングキャリブレーションを行えばよい。

【0028】次に、上記検出装置22の数とスケール板21の大きさの関係について説明する。図7は上記関係を示す図であり、同図(a)は検出装置22を1個設けた場合に必要とされる位置決め用スケール板21の大きさ、同図(b)は検出装置22を2個設けた場合に必要とされる位置決め用スケール板21の大きさを示しており、同図中のAはスケール板の有効移動範囲、また、位置決め用スケール板21における斜線の部分は位置決め用マークが印された範囲である。

【0029】検出装置22により位置決め用スケール板21上の位置決め用マークを少なくとも1個検出する必要があるので、検出装置22の数が1個で、検出装置22がスケール板の有効移動範囲Aの中心に配置されている場合には、位置決め用スケール板21として、同図(a)に示すように、少なくとも位置決め用スケール板21の有効移動範囲の1/4の大きさが必要となる。また、検出装置22の数が2個で、ぞれぞれの検出装置22が同図(b)に示すようにスケール板の有効移動範囲Aを3分割した位置に配置されている場合には、位置決め用スケール板21として、同図(b)に示すように、少なくとも位置決め用スケール板21の有効移動範囲の

1/6の大きさが必要となる。以下同様に、検出装置2

2の個数を多くすることにより位置決め用スケール板 2

1の大きさを小さくすることができる。

【0030】なお、上記実施例では、位置決め用スケール板21を $\theta$ ステージ13の裏面に取り付ける場合について説明したが、本発明においては、 $\theta$ ステージ13は必ずしも必要でなく、 $\theta$ ステージを設けない場合には、上記位置決め用スケール板21をXステージ11の裏面に取り付ければよい。また、上記実施例では逐次露光におけるX, Yステージの位置決めについて説明したが、本発明の適用対象は上記実施例に限定されるものではなく、比較的長ストロークで高精度にXYステージを位置決めする必要のある各種の装置に適用することができる。

### [0031]

【発明の効果】以上説明したように本発明においては、第1のステージの裏面に位置決め用マークを全面に設けた板状部材を取り付けるとともに、上記位置決め用マークの位置を検出する検出手段を設け、第1、第2のステージを所定量移動させたのち、上記位置決め用スケール板に設けられた位置決め用マークの位置を上記検出手段で検出し、検出結果に基づき位置ずれを補正するように構成したので、高価なレーザ干渉測長器を使用することなく、第1、第2のステージを高精度に位置決めすることができる。また、第1,第2のステージを移動させるボールネジやガイド等の送り機構に高精度な部品を使用する必要がなく、装置の価格を低減化することができる必要がなく、装置の価格を低減化することができる

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例のワークステージの全体構成を 示す図である。

【図2】本発明の実施例の制御部の構成を示す図である。

【図3】位置決め用スケール板に印された位置決め用マークの一例を示す図である。

【図4】モニタの画面上に表示された位置決め用マーク を示す図である。

【図5】本発明の実施例の位置決め手順を説明する図で

8

| 4 | 4 | ٠ | ١ |
|---|---|---|---|

| ある。  |                      |
|------|----------------------|
| 【図6】 | 位置決め用マークが本来あるべき位置を求め |

方法を説明する図である。 【図7】検出装置数とスケール板の大きさの関係を説明

【図8】従来のワークステージの概略構成を示す図である。

【図9】レーザ干渉測長計を用いたワークステージの位 置測定方法を示す図である。

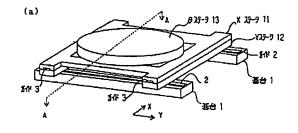
## 【符号の説明】

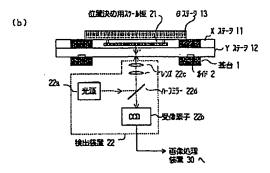
する図である。

| 1    | 基台      |
|------|---------|
| 2, 3 | ガイド     |
| 1 0  | ワークステージ |
| 1 1  | Xステージ   |
| 1 2  | Yステージ   |

【図1】

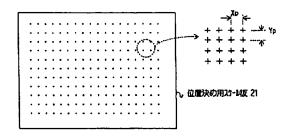
#### 本発明の実施例のワークステージの全体構成を示す図





[図3]

位置決め用スケール仮に印された位置決め用マークの一例を示す図



13 θステージ

| 2 | 1 | 位置決め用スケール板     |
|---|---|----------------|
| ~ | 1 | 11にほんりの ヘクニングな |

22 検出装置

2 2 a 光源

2 2 b 受像案子

22d ハーフミラー

22c レンズ

30 画像処理装置

31 モニタ表示

32 コントローラ

33a Xステージ駆動機構

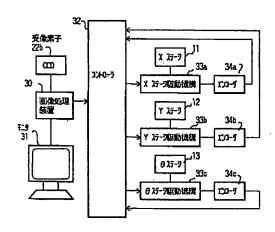
33b Yステージ駆動機構

33c
θステージ駆動機構

34a, 34b, 34c エンコーダ

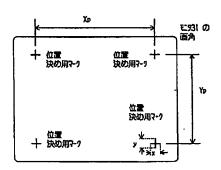
#### 【図2】

#### 本発明の実施例の制御部の構成を示す図



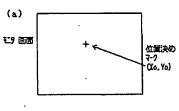
[図4]

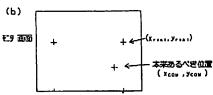
モニタの画面上に表示された位置決め用マークを示す図



[図5]

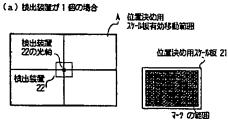
## 本発明の実施例の位置決め手順を説明する図

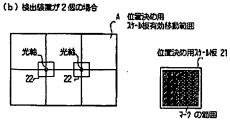




[図7]

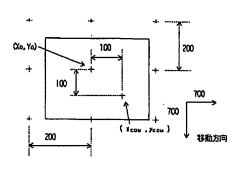
#### 検出装量数とスケール板の大きさの関係を説明する図





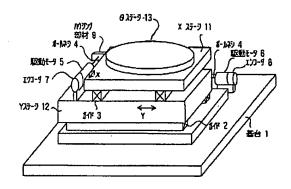
【図6】

## 位置決め用マーケが本来あるべき位置を求める方法を説明する図



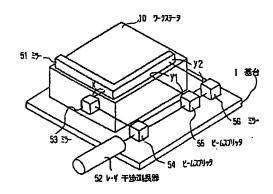
【図8】

従来のワークステージの概略構成を示す図



【図9】

レーザ干砂湖是計を用いたワークステージの位置測定方法を示す図



フロントページの続き

(51) Int.C1.6

識別記号

FΙ

B 2 3 Q 1/28

1/18

Α